

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-072

无锡市太极实业股份有限公司

关于为子公司太极半导体银行授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
太极半导体(苏州)有限公司	10,000 万元	21,179.74 万元	是	否

注：“实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）”系截至 2025 年 11 月 30 日无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司太极半导体（苏州）有限公司（以下简称“太极半导体”）实际提供的担保余额（其中外币担保余额已根据 2025 年 11 月末汇率折算为人民币）。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	75,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	8.82
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	-

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足业务发展需要，公司为子公司太极半导体向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“建设银行苏州高新区支行”）申请授信续期提供 10,000 万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。近日，公司与建设银行苏州高新区支行就上述担保事项完成了《本金最高额保证合同》的签署。

（二）内部决策程序

公司第十届董事会第二十五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度为子公司太极半导体银行授信提供不超过 6 亿元人民币的担保。其中，为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过 15,100 万元人民币的担保，为太极半导体向银行申请授信续期提供不超过 44,900 万元人民币的担保（含授信期限内的担保续期）。预计的担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2025-013）。

本次担保事项在公司给予太极半导体 2025 年度担保预计的 6 亿元授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

本次担保后，在上述股东大会审议担保额度及有效期内，公司可为太极半导体向银行申请新增授信提供的担保额度为 8,100 万元，可为太极半导体向银行申请授信续期提供的担保额度为 34,900 万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	太极半导体（苏州）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 85.06% 公司全资子公司太极微电子（苏州）有限公司持股 14.94%
法定代表人	孙鸿伟
统一社会信用代码	913205940601875249

成立时间	2013 年 1 月 9 日		
注册地	苏州工业园区综合保税区启明路 158 号建屋 1 号厂房		
注册资本	72,210.8475 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	研究、开发、封装、测试生产半导体产品，并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电子元器件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；电子元器件批发；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	103,142.94	100,079.76
	负债总额	53,177.71	47,587.82
	资产净额	49,965.23	52,491.94
	营业收入	52,226.27	75,182.49
	净利润	-2,526.71	113.45

三、担保协议的主要内容

公司与建设银行苏州高新区支行签署的《本金最高额保证合同》主要内容为：

保证人（甲方）：无锡市太极实业股份有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

鉴于乙方为太极半导体（苏州）有限公司（下称“债务人”）连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、贸易融资类业务等其他授信业务而将要（及/或已经）与债务人在 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 12 日期间（下称“主合同签订期间”）签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（在主合同签订期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文件下称“主合同”）。

甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。根据有关法

法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。

1、保证范围

主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）壹亿元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

2、保证方式

甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

3、保证期间

(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

(2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

4、主合同变更

甲方同意，乙方与债务人签订主合同或对主合同进行任何变更（包括但不限于延长债务履行期限或增加债权本金金额），均无需通知甲方，甲方仍应在本合同约定的担保范围内承担担保责任。

甲方的保证责任不因出现下列任一情况而减免：(1)乙方或债务人发生改制、合并、兼并、分立、增减资本、合资、联营、更名等情形；(2)乙方委托第三方履行其在主合同项下的义务。

主合同项下债权转让的，本合同项下的保证随之转让。

主合同项下债权或债务的转移行为未生效、无效、被撤销、被解除，甲方仍

按照本合同对乙方承担连带保证责任。

5、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，也可向乙方住所地人民法院起诉。

在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

6、合同生效条件

本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司太极半导体银行授信提供担保，系基于太极半导体的业务发展需要，有利于满足其生产经营资金需求，保障其业务的正常开展，符合公司整体利益。

被担保方太极半导体为公司全资子公司，公司能够全面了解并及时掌握其经营情况及财务状况。太极半导体资信状况良好、具备偿债能力，本次担保风险可控。本次担保在股东大会审议批准的额度范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》并提交公司股东大会审议。公司2024年年度股东大会已审议通过前述议案。

董事会认为：公司本次担保系根据子公司业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对本公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 75,000 万元，占公司 2024 年经审计归母净资产的 8.82%；公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为 75,000 万元，占公司 2024 年经审计归母净资产的 8.82%。公司及子公司不存在为公司控股股东和实际控制人及其关联人提供担保

的情况，无逾期担保情况。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2025年12月26日